

Title (en)
Method for preparing wood particle boards with an organic binder

Title (de)
Verfahren zur Herstellung organischgebundener Holzwerkstoffe

Title (fr)
Procédé de préparation de panneaux de bois avec un liant organique

Publication
EP 0839616 A2 19980506 (DE)

Application
EP 97114775 A 19970826

Priority
DE 19640593 A 19961001

Abstract (en)
The method involves pressing a mat to be formed into board in a hot plate press for a first press phase period of 20-90 s. The mat is over-compressed to a thickness of 0.80-0.98 of the desired final thickness. The pressure is applied to the mat at least for long enough to allow 50-100 g of water to be sprayed on to the outer surfaces of the mat and for the water to reach the point where steam is starting to form. The energy of the water is such that when the plates are moved apart in a second press phase to a distance equal to the final thickness of the board, there is a secondary steam shock effect causing a spontaneous increase of temperature within the mat of at least 15 degrees .

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren zur Herstellung von Holzwerkstoffen aus lignocellulosehaltigen Partikeln und organischen Bindemitteln beschrieben. Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, daß ein Vlies in der Heißpresse für die Zeit von 20..90 s in einem überverdichteten Zustand entsprechend 0,80...0,98 ·dSoll verbleibt. Die Zeitspanne soll mindestens jedoch solange sein, bis in den durch Aufsprühen von 50..100 g Wasser pro Vliesseite aufgefuechteten Deckschichten eine Änderung des Aggregatzustandes des Wassers von der flüssigen Phase in die Dampfphase stattgefunden hat. Dabei soll der Energiegehalt des Dampfes ausreichend sein, um bei anschließenden Vergrößerung des Preßplattenabstandes auf die Solldicke der Platte (dSoll) in der Vliesmitte eine spontane Temperaturerhöhung T von mindestens 15 °C einzuleiten.

IPC 1-7
B27N 3/08

IPC 8 full level
B27N 3/08 (2006.01); **B27N 3/18** (2006.01)

CPC (source: EP US)
B27N 3/18 (2013.01 - EP US)

Cited by
US6533889B2; EP1009601B2

Designated contracting state (EPC)
AT DE FR GB LU

DOCDB simple family (publication)
US 5942174 A 19990824; AT E215875 T1 20020415; CA 2216992 A1 19980401; CA 2216992 C 20050315; DE 19640593 A1 19980409; DE 59706951 D1 20020516; EP 0839616 A2 19980506; EP 0839616 A3 19990506; EP 0839616 B1 20020410

DOCDB simple family (application)
US 94199897 A 19971001; AT 97114775 T 19970826; CA 2216992 A 19971001; DE 19640593 A 19961001; DE 59706951 T 19970826; EP 97114775 A 19970826